

# Produktdatenblatt

hm2.0 Federleiste Bauform C,  
Art. Nr. 244-31300-15

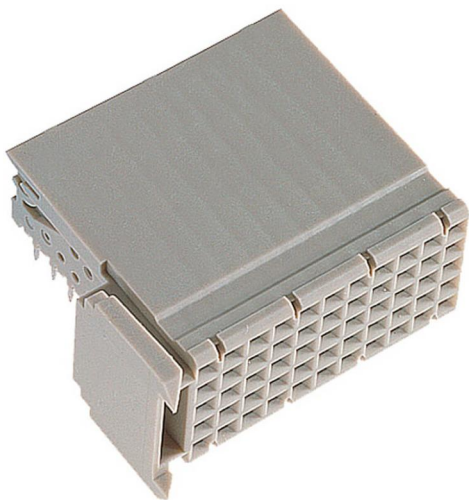


Abbildung ähnlich



Rechtwinklig



Einpresstechnik

- Polzahl 55
- Anschlusslänge 2.9 mm
- für min 1.44 mm Leiterplattendicke
- mit Schirmung
- getestet nach IEC 61076-4-101



» zum Produkt auf [www.ept.de](http://www.ept.de)



» zur Produktgruppe hm 2.0

# Produktdatenblatt

hm2.0 Federleiste Bauform C,  
Art. Nr. 244-31300-15



## Technische Daten

### Grundlagen

Spezifikation	IEC 61076-4-101
Gütestufe	2
Anzahl Kontakte	55
Anschlusstechnik	Einpresstechnik
Anschlusslänge	2.9 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

### Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
CTI Wert <i>IEC 60112</i>	200
Kontaktmaterial	Bronze

### Mechanisch

Rastermaß	2.0 mm
Steckkraft pro Kontakt	Kontakt: max. 0.75 N, Abschirmung: max. 1 N
Ziehkraft pro Kontakt	Kontakt: min. 0.15 N, Abschirmung: min. 0.15 N
Lebensdauer	> 250 Steckzyklen

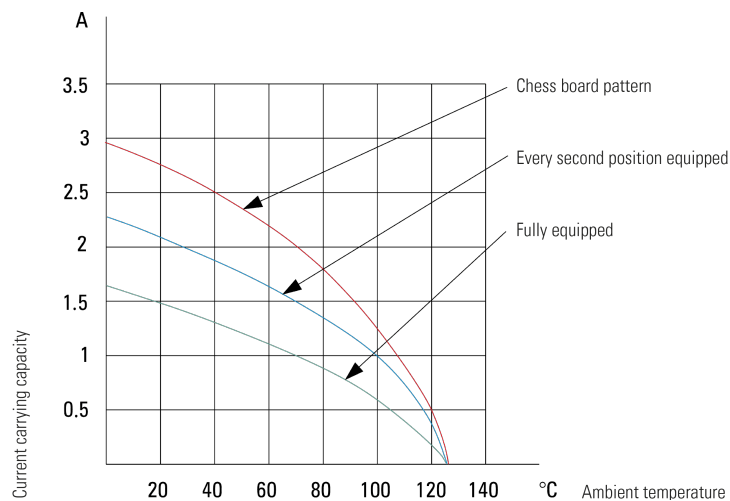
### Elektrisch

Betriebsstrom	1.5 A @ +20°C, 1.0 A @ +70°C
Durchgangswiderstand	max. 20 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	≥ 0.6 mm
Isolationswiderstand	min. 10 <sup>4</sup> MΩ
Prüfspannung	750 V r.m.s
Datenübertragung	3.125 Gbit/s

### Zulassungen / Konformität

UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

### Derating Diagramm



### Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Schicht
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 0.6 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 0.60 ±0.05 mm
<b>C Grundbohrung</b>	0.70 ±0.02 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	max. 1.5 µm; chem. Sn Leiterplatten
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 0.6 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 0.60 ±0.05 mm
<b>C Grundbohrung</b>	0.70 ±0.02 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 0.6 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 0.60 ±0.05 mm
<b>C Grundbohrung</b>	0.70 ±0.02 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	OSP*,z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

Material	HAL Sn Leiterplatten
<b>Nennloch</b>	<b>Ø 0.6 mm</b>
<b>A Leiterplattendicke</b>	min 1.44 mm
<b>B Endloch</b>	Ø 0.60 ±0.05 mm
<b>C Grundbohrung</b>	0.70 ±0.02 mm
<b>D Cu Schicht</b>	min. 25 µm
<b>E Oberfläche</b>	HAL Sn, 5 - 15 µm
<b>F Restring</b>	min. 0.1 mm

# Produktdatenblatt

hm2.0 Federleiste Bauform C,  
Art. Nr. 244-31300-15

---



## Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- Andere Kontaktbeschichtung
- Auch in THTR Technik

## Zubehör

- » hm2.0 unteres Schirmblech Bauform C  
Artikelnummer 244-31600-1

## Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

[» PDF](#)

[» 3D IGES](#)

[» 3D STEP](#)

[» 3D PDF](#)